证券代码: 000628 展

成都高新发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2022-1

.	<u> </u>	细 亏: 2022-1
投资者关系活动类别	√特定对象调研	□分析师会议
	□媒体采访	□业绩说明会
	□新闻发布会	□路演活动
	□现场参观	□电话会议
	√其他:(线上会议)_	
	诺安基金陈衍鹏	
参与单位名	南方基金于泽群	
称及人员	民生证券宋晓东	
姓名	华创证券王彬鹏	
	华西证券郁晾、金兵	
	招商证券谌薇、曹辉、唐笑	
时间	2022年11月8日(星期二)下午三点	
地点	成都森未科技有限公司会议室	
	高新发展董事会秘书杨砚琪; 森未科技董事长、芯未半导体执	
公司接待人	行董事胡强;森未科技CEO王思亮;森未科技财务总监刘志	
员姓名 娟; 芯未半导体总经理助理陈斯; 高		高新发展证券事物代表张涵
	洁	
投资者关系	(一) 公司基本情况介绍。	
	公司于 1992 年 7 月经成都市体制改革委员会批准,由成都高新	
	技术产业开发区管理委员会等四家单位共同发起以定向募集方	
	式设立。公司是国家高新技术产业开发区中第一批股份制试点企	
活动主要内	业,也是国家科委、国家体改委在全国进行科技与经济相结合的	
容介绍	首家股份制试点企业。	
	公司是成都高新区管委会下属唯一国有上市公司,主营业务为建	
	筑业以及智慧城市建设、运营及相关服务业务。2022 年,公司 通过并购整合在IGBT领域具备较强技术实力的森未科技,正式	
	进入功率半导体行业,公司主营业务增加功率半导体业务。	
	四八切平十寸四11 里,石川土昌里。	万归州为于十寸丹业为。

森未科技主营业务为IGBT等功率半导体器件设计、开发和销售。 自 2017 年成立以来,森未科技一直以"致力于成为一流的功率半 导体行业引领者"为愿景,持续推进IGBT功率半导体国产化进 程。

截至目前,森未科技成功构建了森未IGBT芯片库,积累开发近100个芯片规格,产品电压等级覆盖600-1700V,单颗芯片电流规格覆盖5-200A,封装后电流达到3600A。实现了对工控、风光储、新能源汽车等热门应用场景的全覆盖,是国内产品线覆盖最广的IGBT功率半导体公司之一。

(二) 互动回答

1、简要介绍公司转型半导体的原因?

答:公司经过多年发展,主营业务逐渐集中到建筑施工和智慧城市建设、运营及相关服务业务。基本面有明显改善,但距离公司打造为有稳定持续较高盈利能力的优质上市公司的目标,仍有较大差距,继续打造有突出盈利能力和发展前景的新主业仍是公司需要继续着力解决的重点问题。如公司近年年报"未来发展战略"所述,公司将通过内生发展和上市公司并购等多种手段不断做大做强,选好赛道确立充分竞争具备硬核技术的新主业,争取在某一细分领域发展成为具有领先地位和强大影响力的优质上市公司,更好回报广大股东。在此背景下,公司并购整合了功率半导体企业森未科技和芯未半导体,由此正式进入功率半导体行业,建立和提升关键核心竞争力。

2、简要介绍公司转型的总体思路?

答:公司已经确立了一定时期内的"建筑施工与智慧城市结合的新基建+功率半导体"双主业业务架构。公司将以并购森未科技和芯未半导体为基础,背靠成都高新区政府支持和产业资源,发挥上市公司并购、融资、资源整合等优势,将功率半导体打造为公司的强大主业。建筑施工与智慧城市相结合,老基建向新基建转变,提升规模和利润水平,作为公司打造强大功率半导体主业的坚实基础。智慧城市新基建在如充电桩、储能、光伏建筑等终端方面以及上层传感器技术方面也可以和IGBT融合,公司会统筹促进相互发展。

3、公司作为国有企业,支持公司转型的管理层动力是?有考虑股权激励吗?何时能推出?

答:党的二十大报告中强调,必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。同时,多次提及科技创新理念,并指出坚持科技自立自强,加快建设科技强国,加速突破"卡脖子"关键核心技术难题。以半导体为代表的一系列供应链"卡脖子"领域,迫切需要实现国产替代。公司积极响应国家号召,继续秉承使命、愿景和核心价值观。现阶段,公司确立了以"建筑施工与智慧城市结合的新基建+功率半导体"双主业业务架构,并看好国内半导体行业在未来大有可为。

公司 2021 年年报已提到,将构建长效激励机制,捆绑管理层、核心骨干和公司利益,激发发展动力。公司今年收购森未科技后,更具备推出股权激励的条件。当时收购公告已清楚表明将择机推出股权激励,深度绑定森未科技核心团队和吸引更多优秀人才加入,也将公司管理层与未来发展深入绑定。目前,公司正在研究论证相关方案,具备条件后将尽快推出。

- 4、公司转型功率半导体的进展?
- 答: 22 年 6 月,公司以现金方式收购森未科技和芯未半导体控制权,进入功率半导体行业。
- 8月,公司控股股东高投集团与倍特基金管理公司共同发起设立 半导体产业并购基金,服务于高新发展转型,对投资项目筛选、 组织实施及投后管理。并购基金将围绕功率半导体产业链不断为 高新发展培育、储备优质并购标的,助力高新发展做大做强功率 半导体主业。未来条件成熟,符合公司战略方向和定位的优质并 购标的将优先注入高新发展。
- 10 月,公司与森未科技创始人团队等共同投资立启宸基金,推进公司战略转型,夯实功率半导体业务。公司将继续围绕功率半导体产业链并购投资与森未科技可以协同的优质标的,提升功率半导体主业核心竞争力,并合理降低、避免因公司直接介入新行业并购投资可能面临的标的信息不明确、发展前景不明确、整合

经济效益不明确等风险。该基金的设立落实了与森未科技创始人团队约定的共同设立功率半导体并购投资基金的绑定措施。启宸基金合伙协议中约定公司在同等条件下具有优先收购被投资企业股权/股份的权利。

公司将根据标的项目成熟度、规模大小等因素,做好上述两只基金的协同联动。目前,已有项目在挖掘储备中。

5、公司做大做强功率半导体的总体思路?

答:公司积极布局Fab-Lite经营模式,通过建设高端功率半导体器件和组件生产线,实现研发和生产制造核心环节的自主可控。进一步通过精准投资整合产业资源,以最快的速度和最高的效率向功率半导体赛道转型,并构建足够高的行业壁垒。以森未科技为基础,向上下游延展做产业布局,降低产业链协同成本,提高产业链协同效率,从而达到快速做大做强功率半导体新主业的目的。

6、简要介绍森未科技的发展情况?

答:森未科技成立于 2017 年 7 月,先后被认定为成都市高新区 雏鹰企业、成都市集成电路设计企业、国家高新技术企业、四川 省专精特新企业,专注于先进功率半导体器件的国产化。

森未科技核心技术团队由清华大学和中国科学院的博士组成,长期专注于功率半导体器件研发,深耕IGBT芯片技术和产业化 10年以上,累计取得(包含正在注册中的专利数)相关技术专利 30多项,成功开发不同电压等级和应用场景的芯片超过 100款,是国内产品线覆盖最广的IGBT功率半导体公司之一。森未科技的芯片产品全面采用沟槽栅+场截止技术,在高密度、大电流、高电压三个维度的技术优势明显,相关产品已应用于工业变频、特种电源、新能源发电以及新能源车等多个市场领域。

7、森未科技的现有主要产品和技术优势?目前IGBT产品对标英 飞凌第几代?

答:森未科技目前成功构建了IGBT芯片库,积累开发近 100 个芯片规格,电压 600V-1700V,电流 2A-200A。目前IGBT产品可对标英飞凌第七代。

8、公司目前功率半导体的下游的应用主要是什么?在新能源汽车领域的相关产品进展如何?

答:产品已进入高压变频、特种电源、新能源发电及储能市场,后续将重点推进在新能源汽车等领域的应用。目前,产品在新能源汽车领域已进入行业标杆性客户的供应体系,在符合商业保密和信息披露合规的基础上,公司会合法合规公布。

9、现阶段IGBT市场竞争激烈,请问森未科技有哪些核心优势? 答:(1)拥有自有芯片:芯片是IGBT产品的核心,森未在关键技术和产品上有多年积累,目前IGBT芯片库已经有 100 个芯片规格。完善的芯片库能够快速适应新应用场景下的需求和产品迭代;(2)产品得到市场和客户认可和验证:公司产品经过多种高可靠性领域的应用检验,对产品的可靠性和稳定性要求极高,这为公司产品在其他领域应用的稳定性和后续的上量提供有力保障;(3)掌握核心技术:公司拥有IGBT核心设计和工艺的融合能力,以及高端集成封测技术,能够更快实现技术迭代,并适应新能源发电和新能源车等新兴市场的差异化需求。

10、现阶段IGBT供给相对紧张,公司是否有产能的保障? 答:森未科技在产能储备方面有充足的提前量规划,可以满足公司未来发展的需求,但因涉及商业机密不展开具体介绍。

11、芯未半导体的定位是?请介绍下产线建设进度,一二期投产时间?

答: 芯未半导体是公司Fablite模式的核心制造环节,包括局域超薄晶圆的工艺研制平台和完整的集成封装产线,具备车规级通用封装能力和芯片级集成封装能力。计划 2023 年Q4 集成封装线调试拉通,2024年Q1 超薄晶圆工艺平台调试拉通。二期计划在2024年底至2025年初启动,并于2026年投产。

12、具体介绍下建筑施工、智慧城市运营服务业务如何做好转型功率半导体主业的保障?

	答:成都高新区对做大做强高新发展的决心是非常大的,思路也
	是清晰的,会在合法合规的情况下给予公司建筑施工、智慧城市
	运营服务业务更大更好的支持,实实在在更快提升公司业绩,能
	有一个强大的现有主业基本盘,在一定时期内,成为打造强大功
	率半导体新主业的坚实基础。
	13、简要介绍公司剥离低效资产计划?
	答:公司会积极剥离"建筑施工与智慧城市结合的新基建+功率半
	导体"之外的非核心业务资产。期货转让正在证监会审批中。公
	司也针对其他非核心低效资产,根据不同资产类别研究论证相关
	方案。具备条件后我们将尽快实施。
附件清单	无
日期	2022年11月8日